



Initial Product/Process Change Notification

Document # : IPCN22673X

Issue Date: 5 April 2019

Title of Change:	Assembly and Test Capacity Expansion to Greatek (GTK) Taiwan for SSOT5 Products	
Proposed First Ship date:	5 October 2019	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Scott.Brow@onsemi.com>	
Samples:	<p><i>Samples should be available after completion of qualification.</i></p> <p>Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.Samples@onsemi.com></p> <p>Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.</p>	
Type of Notification:	<p>This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan.</p> <p>The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact <PCN.Support@onsemi.com></p>	
Change Part Identification:	<p>Product marked with date code 1923 or later may be built from current factory or from OSPI Factory. On the label of the box and reel, the ASSY LOC: D2 will also indicate product assembled in GTK. Please see sample label on Page 2 at the following URL</p> <p>http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF to see the location of the ASSY LOC.</p>	
Change Category:	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input checked="" type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____	
Change Sub-Category(s):	<input checked="" type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: None	External Foundry/Subcon Sites: Greatek, Taiwan
Description and Purpose:		
<p>ON Semiconductor would like to inform its customers of the qualification of Greatek, Taiwan for the assembly and test of the SSOT-5 products listed in this Final Product Change Notification (FPCN). This is a capacity expansion, and at the end of the FPCN approval cycle, these products may be dual sourced from either ON Semiconductor Cebu Philippines or from Greatek.</p> <p>For assembly and test BOM changes and test platforms associated with this FPCN are shown here:</p>		
	Before Change Description	After Change Description
LeadFrame	SOT23 5L C194 Etched	SOT23 5L C194 Stamped
Die Attach	Loctite ABLESTIK QMI519	Hitachi 4900GC
Mold Compound	Panasonic CK5000A	Sumitomo G600F
Test Platform	MCT/ETS200	ASL1k
Product marking changes are shown here:		
	From	To
Product marking change	Assy Location: D	Assy Location: K



Qualification Plan:

QV DEVICE NAME: FAN3180TSX
RMS : F55820
PACKAGE: SOT23 5L AU SNGL HPBF

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

Estimated date for qualification completion: 21 June 2019

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
FAN3100CSX	FAN3180TSX
FAN3100TSX	FAN3180TSX
FAN3111CSX	FAN3180TSX
FAN3111ESX	FAN3180TSX
FAN3180TSX	FAN3180TSX
FL3100TSX	FAN3180TSX

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22673X

発行日 : 5 April 2019

変更件名:	Greatek (GTK) Taiwan 認定による SSOT5 製品の組立及び検査能力の拡大	
初回出荷予定日:	5 October 2019	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Scott.Brow@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	サンプルは認定完了後に提供が可能となります。 現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
変更部品の識別:	日付コード 1923 以降の日付表示がある製品は、現在の工場または OSPI 工場で組み立てられていることとなります。箱およびリールのラベルに ASSY LOC が記載されています。D2 は GTK で組み立てられた製品も示します。以下の URL にある 2 ページ目のサンプルラベルを参照してください。 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF の ASSY LOC の場所を参照してください。	
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input checked="" type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他	
変更サブカテゴリ:	<input checked="" type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場 / 下請業者拠点: Greatek, Taiwan
説明および目的: オン・セミコンダクターは、この最終製品変更通知 (FPCN) に記載されている SSOT-5 製品の組立及び検査拠点として Greatek Taiwan の認定をお知らせします。これによって生産能力が拡大され、FPCN 承認サイクルが完了した時点で、対象製品はオン・セミコンダクター・セブ(フィリピン)または Greatek の 2 社いずれかから供給されることとなります。 今回の FPCN に関連する組立及び検査の BOM 変更、及びテストプラットフォームについては以下に示します。		
	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	SOT23 5L C194 エッチング	SOT23 5L C194 スタンピング
ダイ接着剤	Loctite ABLESTIK QMI519	Hitachi 4900GC
モールド・コンパウンド	Panasonic CK5000A	Sumitomo G600F
テストプラットフォーム	MCT/ETS200	ASL1k
製品表示の変更について:		
	変更前	変更後
製品表示変更	組み立て場所: D	組み立て場所: K



認定計画:

デバイス名: FAN3180TSX

RMS: F55820

パッケージ: SOT23 5L AU SNGL HPBF

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec	

認定完了予定日 : 21 June 2019

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FAN3100CSX	FAN3180TSX
FAN3100TSX	FAN3180TSX
FAN3111CSX	FAN3180TSX
FAN3111ESX	FAN3180TSX
FAN3180TSX	FAN3180TSX
FL3100TSX	FAN3180TSX